

ライン	クリーム印刷	印刷検査機	チップボンド※1	マウンター(1台目)			マウンター(2台目)			リフロー炉	ライン別対応表※2		
A	TSP-1100	-	YGD	YV-100Xg			-			SOLSYS 8310 IRTR	クリーム最大	ボンド最大	チップサイズ
	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 520*460	【基板厚】 最小0.4 最大3.0	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 380*330	【基板厚】 最小0.3 最大4.0	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 460*440	【基板厚】 最小0.4 最大3.0	【チップサイズ】 最小0603 最大□32	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 330*310	【基板厚】 最小0.4 最大3.0	【チップサイズ】 最小0603 最大□32	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 330*310	最大 330*310	最大 330*310
B	YSP KHT-000	VP-3000L	HSD-X	YV-100Xg			YV-88Xg			TAP30-407EM	クリーム最大	ボンド最大	チップサイズ
	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 510*460	【基板厚】 最小0.4 最大3.0	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 460*440	【基板厚】 最小0.3 最大4.0	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 460*440	【基板厚】 最小0.4 最大3.0	【チップサイズ】 最小0603 最大□32	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 460*440	【基板厚】 最小0.4 最大3.0	【チップサイズ】 最小0603 最大□32	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 330*300	最大 330*300	最大 330*300
C	TSP-1200	-	-	YS-12			YS-12F			SOLSYS 8310 IRTR	クリーム最大	-	チップサイズ
	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 510*460	【基板厚】 最小0.4 最大4.0	-	-	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 510*440	【基板厚】 最小0.4 最大3.0	【チップサイズ】 最小0402 最大□32	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 510*440	【基板厚】 最小0.4 最大3.0	【チップサイズ】 最小0402 最大□45	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 330*310	最大 330*310	-
D	TSP-1100	VP-3000	-	YG-100R			YG-100R			TAP30-407PH	クリーム最大	-	チップサイズ
	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 520*460	【基板厚】 最小0.4 最大4.0	-	-	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 460*440	【基板厚】 最小0.4 最大3.0	【チップサイズ】 最小0402 最大□45	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 460*440	【基板厚】 最小0.4 最大3.0	【チップサイズ】 最小0402 最大□45	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 330*300	最大 330*300	-
E	TSP-600	-	-	YS-12			-			TNV25-508EM-G	クリーム最大	-	チップサイズ
	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 335*255	【基板厚】 最小0.4 最大4.0	-	-	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 510*440	【基板厚】 最小0.4 最大3.0	【チップサイズ】 最小0402 最大□32	-	-	【基板サイズ】 最小 50*50 最大 330*250	最大 330*250	-	-

※1 チップボンドは0603未満は対応不可

※2 供給機対応可能サイズは320*250
(そのサイズを超える場合は手置き対応の為別途相談)

SMT課全ライン総合判定			
最小基板	クリーム最大	ボンド最大	チップサイズ
50*50	330*310	330*310	最小0402 最大□45
全ライン	A.Cライン	Aライン	C.Eライン

Last Update 18.09.21